

高耐熱性 プリント配線板用 水溶性耐熱プリフラックス

Excellent resistance to heat OSP for Multiple Metal finished Printed Circuit Boards



SOLDERITE WPF-21TS

開発品 Under Development

高温リフロー後の耐熱性が良好!

Excellent Resistance to High Temperature Air Reflow

特長 Features

- 耐熱性に優れた有機被膜を形成する為、鉛フリーはんだ実装に対応できます
High heat resistance organic film formation, which means the film is compatible with Pb-free soldering
- 高温リフロー後の溶剤ペーストぬれ性に優れています
Excellent wettability even after high temperature reflow
- 2.4mm厚基板のスルーホールはんだ上がり性に優れています
Excellent through-hole solderability of 2.4mm PCB
- 金メッキの変色を起こさない為、金メッキ混載基板の処理に適しています
Discoloration prevention on gold plating means suitable to multiple metal finished surfaces

溶剤ペーストぬれ性 Wettability

260°C大気リフロー3回後もぬれ性良好
Good wettability observed after 3time air-reflow



スルーホールはんだ上がり性(基板厚 2.4mm) Through-hole Solderability (PCB thickness : 2.4mm)

2.4mm厚基板のスルーホール上がり性良好
Excellent Resistance to High Temperature Air Reflow

